

# 第13回 Additive Manufacturing (AM) シンポジウム

## ～AM 最終製品を目指して～

主催：東京大学生産技術研究所 付加製造科学研究室

開催日時：2023年1月20日（金） 12:30～17:10（受付開始 12:00～）

開催場所：東大生研コンベンションホール リアル開催（webでは対応いたしません）

参加費：無料（但し、後日アンケートのお願いがございます）

申込締切：2023年1月19日（木）18:00までにお申し込みください

（締切日前であっても、人数に達し次第申込を中止させて頂く場合がございます）

募集人員：100名（先着順） 定員に達し次第申込みを締め切ります。

参加条件：参加当日は下記の注意事項をお守り下さいますようお願い致します。お守り頂けない場合は参加をお断りする、または、ご退出頂く場合がございますので、ご了承の上、お申込みください。

- ・ 発熱、体調不良の方、その他新型コロナウイルスの感染を疑う症状のある方はご参加いただけません。
- ・ 会場内ではマスクの着用をお願い致します。また、アルコール除菌剤での手指の消毒、こまめな手洗いにご協力をお願い致します。
- ・ 会場内での会話はできる限りお控えください。
- ・ 講演会場内での飲食は禁止です。
- ・ 着席は間隔をおいてご着席ください。
- ・ 当日は、写真撮影、動画撮影はご遠慮下さい。

### ●お申し込み方法：

こちらの参加申し込みフォームからお申し込みください（お申し込み後の返信はございません。申込後当日会場へお越しください。名刺或いは名刺に変わるカードをご持参受付で提出して下さい）

<https://forms.gle/Z14FE2rrENjHwzQr5>



締切：2023年1月19日（木） 18時まで（定員に達し次第申込を中止いたします）

# プログラム

司会 東京大学生産技術研究所 新野 俊樹

(AMの現状と市場・技術動向)

12:30-13:50 パネルディスカッション  
「formnext22 から得られた AM の今後 (仮題)」

ファシリテーター&「海外動向」報告 東京大学生産技術研究所 新野 俊樹

(報告&ポジションスピーチ 15min)

パネラー 株式会社NTT データザムテクノロジーズ 毛利 孝裕

G F マシニングソリューション株式会社 小林 貞人

パナソニックホールディングス株式会社 阿部 諭

13:50-14:20 光硬化性樹脂を用いる AM の最近の進歩 横浜国大 萩原 恒夫

14:20-14:50 SFFS 報告等 東京大学生産技術研究所 新野 俊樹

休憩 14:50~15:00

15:00-15:30 昨今の金属 PBF について EOS Japan Christopher Schmitz

15:30-16:00 樹脂 PBF の高速化 都立産業技術研究センター 山内 友貴

16:00-17:00 AM 市場の現状 (一社)日本 3D プリンティング産業技術協会 代表理事 三森 幸治

17:00-17:10 クロージングリマーク 東京大学生産技術研究所 新野 俊樹

以上

注：講演者、講演内容は、都合により変更になる場合がございます。

## 当件における連絡先：

株式会社アспект 間野 (マノ)

〒206-0802 東京都稲城市東長沼 3104-1-101

T E L 090-8306-6989

e-mail : amsympo アット iis. u-tokyo. ac. jp (カタカナを@にして下さい)

会場：東京大学生産技術研究所（駒場リサーチキャンパス内）コンベンションホール（An棟）

〒153-0041 東京都目黒区駒場 4-6-1

東京大学生産技術研究所へのアクセスおよびキャンパスアップはこちら

<https://www.iis.u-tokyo.ac.jp/ja/access/>

